

株式会社 日本政策金融公庫 御中

住 所

商号又は名称

署名又はゴム印

代表者名

事業計画書（挑戦支援資本強化特例制度用）

1 事業計画の内容

半導体メーカー及び下請企業が活用する、ICチップの設計にかかるソフトウェアを開発・販売する。

2 商品・サービスの特性

・これまでに設計したICチップの情報（約5,000種類。インターネットによる自動更新で最新情報が取得可能）を画面上に示すことで、設計工程を大幅に短縮化できる。
・導入費用が500千円と競合商品（1,000千円）に比べ、安価な価格設定となっている。

3 競合すると考えられる商品・サービス

・〇〇〇〇〇〇〇〇社（製品名：□□□□□□□□）【△△△県×××市】
・◎◎◎◎◎◎◎◎社（製品名：☆☆☆☆☆☆☆☆）【▲▲▲県★★★市】

4 必要な資金と調達方法

必要な資金		金額	調達の方法		金額
設備資金	店舗、工場、機械、備品、車両など (内訳)	1,000 万円	自己資金		200 万円
	・ パソコン（システム開発用）	760	親、兄弟、知人、友人等からの借入 (内訳・返済方法)		100 万円
	・ システム開発用ソフトウェア	240	日本政策金融公庫 国民生活事業 からの借入		800 万円
			うち、挑戦支援資本強化特例制度		800 万円
			他の金融機関等からの借入		300 万円
運転資金	商品仕入、経費支払資金など (内訳)	700 万円	(内訳・返済方法)		
	・ 広告宣伝費	300	・ △△信用金庫		300
	・ 量産化仕入費用	400	ベンチャーキャピタル等からの出資		300 万円
合 計		1,700 万円	合 計		1,700 万円

5 挑戦支援資本強化特例制度を必要とする理由

新事業に必要な技術に関する特許を取得し、既に試作品は完成している。販売計画を立てたものの軌道に乗せるためには更なる設備投資等が必要である。収益の柱に育つまで少しでも支出を抑えたいため、挑戦支援資本強化特例制度の利用を希望する。

